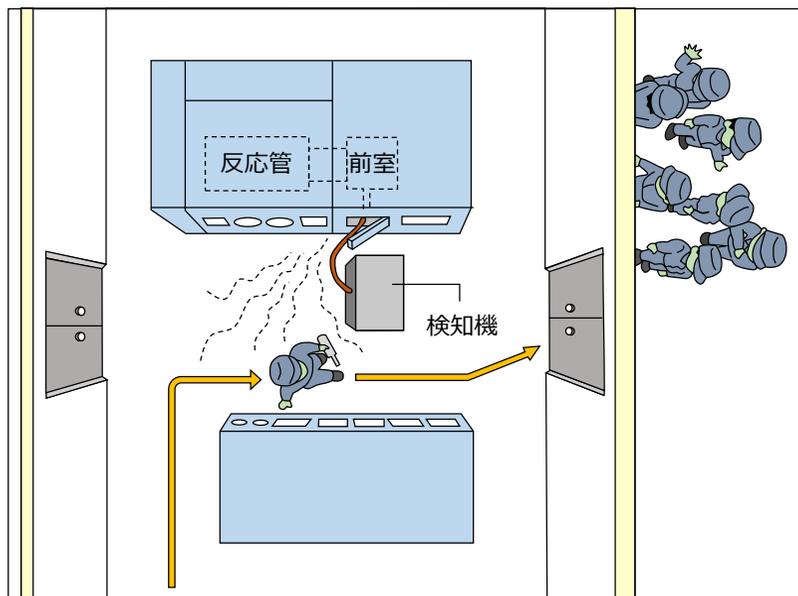


半導体製造装置のメンテナンス作業中に中毒



【発生場所】

半導体製造装置のメンテナンス作業中

【被災原因】

半導体メーカーがメンテナンスを行うために行ったベーキング作業※1および酸化作業※2の打ち合わせ後、半導体製造装置に残留している有害物質を検知管で測定する際に、有害物質が漏洩し、装置の傍を通った際に被災した。

- ※1・・・ベーキング作業：反応管内にガスボンベから水素を送入し、温度を上げることにより装置内の有害ガスを取り除く作業
- ※2・・・酸化作業：ボンベから酸素および窒素を送入し、反応管に付着している有害物質と反応させて酸化膜を生成させ、発散するリン等の有害物質を抑制する作業

【被災状況】

被災者は、事務所で約1時間休憩後も体調不良のため、メーカーの産業医の診察を受け、さらに産業医の指示で大学病院で診察を受けたところ、急性薬物中毒の診断を受け4日間の入院となった。

【対策】からの抜粋

[1] 装置の扉を開放しないで有害物質の検知ができるようにすること。装置内の有害物質等の検知を扉を開けて行わなくても出来るように検知システムを自動化する等の検討を行う。



～理研計器からのご提案～

有害物質を使用したり、発生が予見される作業を行う場合、作業前の環境濃度の確認、作業中の周囲への漏洩確認、作業後の原状回復確認にガスモニターのご使用をお勧めいたします。